

上海万业企业股份有限公司

关于认购上海半导体装备材料产业投资基金 的进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2017年4月27日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)九届九次董事会审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金(筹)的关联交易议案》，详情请见公司《关于拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金(筹)的关联交易公告》(公告编号：2017-014)，公司拟以自有资金10亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金(筹)20%的份额。该议案已经2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过。

2017年7月21日，上海集成电路装备材料产业投资基金(筹)参与各方签署《上海集成电路装备材料产业投资基金出资人合作备忘录》，明确了具体出资人、出资额以及基金管理模式(公告编号：2017-027)。

后经工商核准，上海集成电路装备材料产业投资基金(筹)正式命名为“上海半导体装备材料产业投资基金”(以下简称“基金”)。

2018年1月19日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。详情请见公司《关于认购上海集成电路装备材料产业投资基金(筹)的进展情况公告》(公

告编号：2018-001)。

二、进展情况

2018年8月7日,公司收到上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)通知,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案信息如下:

基金名称:上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海半导体装备材料产业投资管理有限公司

托管人名称:南京银行股份有限公司

备案编码:SEG790

截至目前,根据《上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》的相关条款,公司已实缴首期40%出资额4亿元。

公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年8月9日